規格表

PowerEdge R770AP

可擴充的運算能力支援企業創新

Dell PowerEdge R770AP 經過專門設計，可以大規模地整合要求極高的企業級工作負載。這部機器具備密集運算能力、進階的記憶體頻寬以及安全的生命週期管理，能夠支援大規模虛擬化、關鍵任務資料庫、分析及 AI 驅動的應用程式，而且具有 PowerEdge 經實證的可靠性。

主要優勢

無與倫比的運算密度

- 最多 2 顆 Intel® Xeon® 6 6900 系列處理器，每顆具備最多 128 個 P-core
- 支援數千個並發使用者、即時分析和高效能模擬

進階記憶體與儲存架構

- 每個插槽 12 條 DDR5 DIMM (最高 3 TB 和 6400 MT/秒)
- 最多 16 個採用 PCIe Gen 5.0 標準的 2.5 吋 NVMe 磁碟機
- 最多 32 個採用 PCIe Gen 5.0 標準的 E3.S NVMe 磁碟機
- 與前幾代產品相比，存取記憶體的速度增加 1.87 倍，而且儲存頻寬提高最多 2 倍

彈性擴充和連線能力

- 最多 5 個 PCIe Gen 5.0 插槽，以及兩個 OCP NIC 3.0 插槽
- 伺服器對伺服器高速通訊，而且可以隨著工作負載發展輕鬆擴充

安全的簡化管理

- 硬體式晶片信任根以及經過加密簽名的韌體
- 透過系統鎖定和自我加密磁碟機保護靜態資料
- iDRAC 與 OpenManage 整合，提供安全的端對端生命週期管理

專為永續效率設計

- 經過最佳化，可提供進階的氣冷功能且支援高效率的電力管理
- 降低營運成本，並同時支援資料中心的永續成長

為何選擇 PowerEdge R770AP？

R770AP 結合高核心密度、進階的記憶體頻寬，以及值得信賴的 PowerEdge 系統復原能力，專為對效能與可靠性皆有嚴格要求的企業環境打造。這部機器的執行規模足以應付大量的工作負載，其效率有助於控制營運成本，亦擁有保護關鍵資料的安全性，使其成為企業創新的基礎伺服器。

本文件提供完整的產品功能清單。但是，標有星號 (*) 的功能在產品推出時可能尚無法使用，會在未來的更新中加入。請注意，本文件並未確認任何功能的可用性或發佈時間表。如需功能可用性最準確且最新的相關資訊，請參閱 dell.com 上的產品組態工具頁面。

特性	技術規格
處理器	兩個 Intel® Xeon® 6 6900 系列搭載 P-core 的處理器，擁有最多 128 核心。
記憶體	• 24 個 DDR5 DIMM 插槽，最高支援 RDIMM 3 TB，速度最高可達 6400 MT/s • 僅支援暫存式 ECC DDR5 DIMM 注意：已安裝的處理器可能會降低 DIMM 的運作速度
儲存控制器	• 內部控制器 (RAID)：PERC H975i DC-MHS 前端 • 外接式控制器：N/A • 內部開機：Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS)：HWRAID 1，2 個 M.2 NVMe SSD 或 USB
磁碟機槽	前側凹槽： • 無背板組態 • 最多 16 個 G5 4 通道 2.5 吋 NVMe (SSD)，最大 245.76 TB • 最多 16 個 G5 2 通道 2.5 吋 NVMe (SSD)，最大 245.76 TB • 最多 32 個 EDSFF E3.S Gen5 NVMe (SSD)，最大 491.52 TB 後置磁碟機槽：不適用
電源供應器	• 1500 W 鈦金級 100-120 LLAC 或 200-240 HLAC，240 VDC，熱交換備援** • 1800 W 鈦金級 200-240 HLAC，240 VDC，熱交換備援 • 2400 W 鈦金級 100-120 LLAC 或 200-240 HLAC，240 VDC，熱交換備援** • 3200 W 鈦金級 200-220 HLAC 或 220.1-240 HLAC，240 VDC，熱交換備援** • 3200 W Titanium 277Vac 與 HVDC，熱交換備援*
散熱選項	空氣散熱
風扇	• 最多 6 個可熱交換風扇
尺寸	• 高度 – 86.8 mm (3.42 吋) • 寬度 – 482 mm (19.0 吋) • 深度 – 802.40 mm (31.59 吋) 含外框 • 深度 – 801.51 mm (31.56 吋) 不含外框
外型規格	2U 機架式伺服器
嵌入式管理	• iDRAC10 • iDRAC direct • 支援 redfish 的 iDRAC RESTful API • RACADM CLI • iDRAC 服務模組
前蓋	選配金屬外框
安全性	• 透過密碼編譯的簽署韌體 • 資料重設加密 (使用本機或外部金鑰管理的 SED) • Secure Boot (安全開機) • 安全的元件驗證 (硬體完整性檢查) • Secure Erase • Silicon Root of Trust • 系統鎖定 (需要 iDRAC10 Enterprise 或 Datacenter) • TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認證 • 機箱入侵偵測
OCP 網路選項	最多兩張 OCP NIC 3.0 卡 • 插槽 4，1 個 x8 或 1 個 x16 Gen5 OCP 3.0 • 插槽 10，1 個 x16 Gen5 OCP 3.0
內嵌式 NIC	• 1 Gb 專用 BMC 乙太網路連接埠
GPU 選項	不適用
連接埠	正面連接埠 • 1 個 USB 2.0 Type-C 連接埠 背面連接埠 • 1 個專用 BMC 乙太網路連接埠 • 2 個 USB 3.1 Type-A 連接埠 • 1 個 VGA 內部連接埠 • 1 個 USB 3.1 Type A 連接埠
PCIe	最多 5 個 Gen5 PCIe 插槽 (x16 連接器) • 插槽 2，1 個 x16 Gen5 (x16 連接器) 全高，半長 • 插槽 3，1 個 x16 Gen5 (x16 連接器) 全高/半高，半長 • 插槽 9，1 個 x16 Gen5 (x16 連接器) 全高/半高，半長 • 插槽 7，1 個 x16 Gen5 (x16 連接器) 全高，半長 • 插槽 5，1 個 x16 Gen5 (x16 連接器) 全高，半長
作業系統和 Hypervisor	• Canonical Ubuntu Server LTS • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware vSAN/VMware ESXi* • Microsoft Windows • Microsoft Windows Server • Microsoft Windows Server Datacenter 如需規格和互用性詳細資料，請參閱 **Dell.com/OSsupport**。
提供 OEM 版本	從邊框、BIOS 到包裝，您可以讓伺服器的外觀與風格就像由您親手設計及打造一般。如需更多資訊，請造訪 **Dell.com/OEM**。

*產品上市時未提供此功能。請參閱 Dell.com 的產品組態工具頁面，以確認功能可用性。

注意：從邊框、BIOS 到包裝，我們的 OEMR 平台可讓您的伺服器呈現彷彿由您親自設計和打造的外觀與質感，而 XL 平台則為 OEM Solutions 客戶提供延長的轉換期和穩定性。如需更多資訊，請造訪 Dell.com ->「解決方案」->「OEM 解決方案」。

APEX on Demand

APEX Flex on Demand 取得您需要的技術來支援不斷變化的業務，付款方式可依實際使用情況調整。
如需更多資訊，請瀏覽 **www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm**。

注意：本文件提供完整的產品功能清單。但是，標有星號 (*) 的功能在產品推出時可能尚無法使用，會在未來的更新中加入。請注意，本文件並未確認任何功能的可用性或發佈時間表。如需功能可用性最準確且最新的相關資訊，請參閱 dell.com 上的產品組態工具頁面。

深入探索 PowerEdge 伺服器

深入瞭解 PowerEdge 伺服器的服務

深入瞭解我們的系統管理解決方案

搜尋我們的資源庫

在 X (之前為 Twitter) 上追蹤 Dell Technologies

聯絡 Dell Technologies 專家以獲得銷售協助或技術支援

版權所有 © 2025 Dell Inc. 保留一切權利。Dell Technologies、Dell 與其他商標均為 Dell Inc. 或其子公司的商標。
其他商標是屬於其各自擁有者之商標。

2025 年 12 月